



لایه نشانی پلاسما (PECVD)

PECVD فرایندی است که طی آن لایه های نازکی از مواد گوناگون در دمای پایین بر روی زیر لایه قرار می گیرد. دمای لایه نشانی، با توجه به اثر پلاسما در کاهش انرژی فعالسازی واکنش، می تواند به شکل چشمگیری کاهش بیابد. پلاسما از طریق تزریق گاز واکنش دهنده بین دو الکتروود موازی، یک الکتروود زمین شده و یک الکتروود متصل به مولد RF، تولید می شود. جفت شدگی خازنی بین دو الکتروود باعث تبدیل گاز به پلاسما، تولید گونه های شیمیایی و در نتیجه لایه نشانی فیلم های نازک بر روی زیر لایه می شود. دمای زیر لایه، که بر روی الکتروود زمین شده قرار می گیرد، از دمای اتاق تا دمای ۳۵۰ درجه قابل تغییر است. دمای سیستم به نوع لایه نشانی بستگی دارد. اصول اساسی لایه نشانی پلاسمایی مشابه اچینگ پلاسمایی است؛ با این تفاوت که در اینجا یک لایه نازک به جای برداشته شدن، بر روی زیر لایه نشاندن می شود.

مشخصات

- ورودی: ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب
- خروجی: ۱۳/۵۶ مگاهرتز، ۵۰ اهم
- بیشینه توان خروجی: ۵۰۰ وات
- فشار کاری: خلا
- نمونه قابل پردازش: جامد
- جنس الکتروودها: مس
- ابعاد دستگاه: به قطر و ارتفاع ۲۵ سانتی متر

ساخت سیستم لایه نشانی پلاسما بر اساس سفارش در ابعاد نیمه صنعتی و صنعتی

SATIA

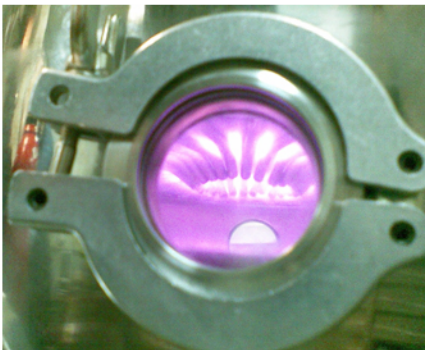
مزایای دستگاه لایه نشانی پلاسما

ویژگی‌ها

- توانایی ایجاد خلاهای بالا (۱۰-۷ میلی بار)
- نگه دارنده زیرلایه با قابلیت کنترل دما
- اندازه زیرلایه: ۱۰×۱۰ سانتی متر
- دمای فرایند: تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد
- دارای چندین ورودی گاز به همراه کنترل کننده جریان گاز
- کنترل پیوسته فشار داخل محفظه
- دارای پمپ توربو برای ایجاد خلا
- یکنواختی و کیفیت بالای لایه‌های نشانداده شده

- دمای پایین نسبت به دستگاه های CVD مرسوم
- کنترل تنش لایه با تکنیک ترکیب فرکانس های بالا و پایین
- پاکسازی محفظه با پلاسما و بدون نیاز به مواد شیمیایی، سمی و مرطوب
- کنترل استیوکیومتری فرایندها
- توانایی لایه نشانی با کیفیت طیف گسترده ای از مواد شامل: SiOx, SiNx و SiOxNy قابل کاربرد در ساختارهای فوتونیک، passivation، پوشش های سخت و غیره
- سیلیکون آمورف (a-Si:H)
- تنوس و اکسید سیلیسیم
- SiC
- لایه نشانی DLC

کاربردهای دستگاه لایه نشانی پلاسما



- پزشکی و دارویی
- حفاظت ایمپلنت ها
- حفاظت لوازم جراحی
- پوشش های زیست سازگار
- پردازش محیط های آلوده
- استرلیزاسیون لوازم پزشکی
- امراض پوستی
- سرطان
- دندانپزشکی
- بهبود زخم
- سنسورها
- میکروفن های کوچک
- سنسورهای گاز و بخار (الکتریکی، نوری و اثرات مربوط به ساختار)
- ساخت و تولید
- پوشش های حفاظتی ابزار برش
- پوشش های غیرچسبناک
- بسته بندی
- ایجاد پوشش های مقاوم در برابر نفوذ گاز و بخار بر روی زیرلایه های انعطاف پذیر
- کشاورزی
- غیرفعالسازی آنزیم
- رفع آلودگی دانه و بذر
- صنایع غذایی
- پردازش مواد غذایی
- ضدعفونی کردن مواد غذایی
- بسته بندی مواد

- پارچه و نساجی
- پوشش های آبدوست
- پوشش های آب گریز
- پارچه های ضدعفونی
- عامل دار کردن سطوح
- تغییر میزان زبری سطوح
- میکروالکترونیک و میکروسیستم ها (اپتیک، فوتونیک، مخابرات و تکنولوژی اصلاعات)
- سیستم های ترانزیستوری میکروالکتروشمیایی (MEMS)
- فیلترهای تداخلی اپتیکی (شامل پوشش های ضد بازتاب (AR)
- لنزهای چشمی
- موجرهای نوری
- نمایشگرها
- پوشش های محافظتی و تزئینی
- پوشش های اپتیکی بر روی پلاستیکها
- پوشش های محافظتی برای ذخیره سازی مواد
- هوافضا
- پوشش های محافظتی در برابر فرسایش و خوردگی
- حفاظت در برابر مخاطرات فضا (اکسیژن اتمی، تابش، حرارت و انباشت بار)
- خودرو
- پوشش حفاظتی قطعات موتور (کاهش سایش و اصطکاک)
- پوشش حفاظتی سیستم های نوری (مقاومت در برابر خوردگی)
- پوشش حفاظتی برای جلوگیری از اتلاف سوخت (سدهای نفوذ ناپذیر)
- تولید و انباشت انرژی
- فوتولتایی (سیلیکون بلوری و آمورف، پوشش های AR)
- پوشش حفاظتی سلول های سوختی
- پوشش های مقاوم به خوردگی
- سطوح خود-پاک شونده (فوتوکاتالیستی)
- پنجره های هوشمند